



导电银胶

EG-4101

**1.介绍**

1 是一款柔性的导电银胶，具有低应力、高导电、高导热等特点，对大多数 CTE 不匹配的基材具有出色的粘接力，适用于陶瓷、铜或铝基板上的大面积芯片/基材粘接。

1 在 80-100℃的温度下可进行返工。

- 2.特征**
- 1) 低应力；
  - 2) 高导电；
  - 3) 高粘接性；

**3.一般特性**

试验项目	单位	代表值	测定方法
外观	-	银色膏状	目视
粘度（25℃）	cp	50000	Brookfield 粘度计，5rpm
密度	g/cm <sup>3</sup>	5.20	比重杯
操作时间（25℃）	hour	12	-
硬度（Shore A）	-	90	邵氏硬度计
粘接强度	MPa	>12	推力机
连续工作最高温度	℃	200	-
玻璃化转变温度	℃	-	DSC
线性热膨胀系数	ppm/℃	-	TMA
热传导率	W/m•K	7.0	激光导热仪
介电强度	kV/mm	-	耐压测试仪
体积电阻率	ohm-cm	<2×10 <sup>-4</sup>	电阻测试仪

**4.标准固化条件**

推荐：150℃×60min；具体的固化方案客户可根据实际应用进行调整。

**5.注意事项**

- 1) 未开封包装在-40℃下的保质期为 12 个月；
- 2) 应被冷冻运输和存储直到被使用；
- 3) 使用前应将胶黏剂在环境温度下解冻回温，时间应不少于 60 分钟；
- 4) 施胶前将针筒外壁水汽擦拭干净，施胶时应保持基板洁净以达到最佳的粘接性能。